

# 广东利扬芯片测试股份有限公司

## 关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 2026 年度公司及全资子公司拟向银行、其他金融机构申请总额度不超过人民币 25.00 亿元（或等值外币）的综合授信额度。
- 被担保人均均为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，即上海利扬创芯片测试有限公司、东莞利扬芯片测试有限公司、上海光瞳芯微电子有限公司及利阳芯（东莞）微电子有限公司。
- 公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总计不超过人民币 25.00 亿元（或等值外币）的综合授信融资额度，并为全资子公司提供不超过人民币 25.00 亿元（或等值外币）的担保额度，截至本公告披露日，公司对外担保余额为 53,292.49 万元，均为公司对子公司连带责任担保，未发生对外担保逾期的情况。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。
- 本次担保不涉及反担保。
- 有效期限：自股东会决议通过之日起 12 个月内有效。

### 一、2026 年度申请综合授信及担保情况概述

#### （一）向银行、其他金融机构申请授信融资额度情况

为满足公司 2026 年业务发展需要，公司及全资子公司 2026 年度拟向银行、其他金融机构申请综合授信总额不超过人民币 25.00 亿元（或等值外币）。授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、信托等，具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

为提升贷款融资授信效率，拟以公司的资产包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等作为担保品，担保形式包括但不限于保

证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本次申请综合授信事项尚需提交股东会审议，有效期自股东会决议通过之日起 12 个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

### （二）公司申请综合授信额度提供担保情况

公司控股股东、实际控制人黄江先生及其配偶拟为公司及全资子公司向银行、其他金融机构申请综合授信提供不超过人民币 25.00 亿元（或等值外币）的连带责任担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，黄江先生为公司控股股东、实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则第 7.2.11 条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

为保障子公司经营活动中的融资需求，需要公司对全资子公司提供直接融资或担保，其中公司及子公司 2026 年度给全资子公司提供直接融资，共计不超过总额人民币 25.00 亿元（或等值外币）；公司及子公司 2026 年度给全资子公司提供融资性担保，共计不超过总额人民币 25.00 亿元（或等值外币）。担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向银行、其他金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

### （三）相关审议程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。公司关联董事黄江、黄主、黄帝祺予以回避表决。

本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### (一) 上海利扬创芯片测试有限公司

公司名称：上海利扬创芯片测试有限公司

住所：上海市嘉定区永盛路 2229 号 3 幢 1 层、2 层（一照多址企业）

法定代表人：黄江

注册资本：人民币 20,000 万元整

成立日期：2016 年 12 月 6 日

经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据(2025 年度)：资产总额 44,451.26 万元；负债总额 27,970.70 万元；资产净额 16,480.56 万元；营业收入 11,138.43 万元；净利润-4,977.67 万元。

### (二) 东莞利扬芯片测试有限公司

公司名称：东莞利扬芯片测试有限公司

住所：广东省东莞市东城街道伟丰路 5 号 8 栋

法定代表人：黄江

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

成立日期：2020 年 7 月 2 日

经营范围：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据(2025 年度): 资产总额 110,019.51 万元; 负债总额 68,279.66 万元; 资产净额 41,739.85 万元; 营业收入 12,766.56 万元; 净利润-2,756.80 万元。

### (三) 利阳芯(东莞)微电子有限公司

公司名称: 利阳芯(东莞)微电子有限公司

住所: 广东省东莞市东城街道裕园街 1 号

法定代表人: 黄江

注册资本: 人民币伍仟万元

成立日期: 2023 年 9 月 11 日

经营范围: 一般项目: 集成电路制造; 集成电路销售; 集成电路芯片及产品制造; 集成电路芯片及产品销售; 电子元器件制造; 电子元器件零售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 货物进出口; 技术进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

与上市公司的关系: 公司全资子公司

主要财务数据(2025 年度): 资产总额 14,766.54 万元; 负债总额 7,211.96 万元; 资产净额 7,554.58 万元; 营业收入 2,739.26 万元; 净利润-1,429.49 万元。

### (四) 上海光瞳芯微电子有限公司

公司名称: 上海光瞳芯微电子有限公司

住所: 上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J

法定代表人: 黄江

注册资本: 人民币壹亿元

成立日期: 2023 年 6 月 7 日

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 集成电路设计; 集成电路芯片设计及服务; 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 软件开发; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 货物进出口; 技术进出口; 集成电路销售; 集成电路芯片及产品销售; 电子元器件批发。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（2025 年度）：资产总额 1,742.78 万元；负债总额 104.51 万元；资产净额 1,638.27 万元；营业收入 7.05 万元；净利润-334.39 万元。

### 三、授信及担保协议的主要内容

公司将就上述事项与相关方签署合同或协议并按照约定执行，上述计划综合授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和控股股东、实际控制人拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或其他金融机构审核同意，以实际签署的合同或协议为准。

### 四、相关授信及担保的原因及必要性

本次授信及担保事项为满足公司及全资子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 五、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供融资或担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及全资子公司为全资子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。综上，董事会同意公司及子公司申请 2026 年度综合授信额度并提供融资或担保事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

### 六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 53,292.49 万元，均为公司对子公司的连带责任担保，未发生对外担保逾期的情况。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日